公司代码:688352
转债代码:118059

公司简称:颀中科技
转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基准向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 118,903,7288 万股,扣减回购专用证券账户中股份总数 8,714,483 股后的股本 1,180,322,805 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 59,016,140.25 元(含税)。2025 年度,公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为 118,032,280.50 元(含税),本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 100,398,688.97 元,现金分红和回购金额合计 218,430,969.47 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的 82.18%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司 2025 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	颀中科技	688352	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余成强	陈颖 / 龚玉娇
联系地址	江苏省苏州市工业园区凤里街 166 号	江苏省苏州市工业园区凤里街 166 号
电话	0512-88185678	0512-88185678
传真	0512-62531071	0512-62531071
电子信箱	irsm@chipmore.com.cn	irsm@chipmore.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务。公司秉持“以技术创新为核心驱动力”的研发理念,通过超过二十年的研发积累和技术攻关,在凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量工艺经验,相关技术适用于显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等不同种类的产品,可以满足客户高性能、高品质、高可靠性封装测试需求。

显示驱动芯片封测业务是公司设立以来发展的重点领域。显示驱动芯片是显示面板的主要控制芯片在之一,被称为显示面板的“大脑”,主要功能是以电信号的形式向显示面板发送驱动信号和数据,通过对屏幕亮度和色彩的控制,使得诸如字母、图片等图像信息得以在屏幕上呈现。

随着显示面板的分辨率及清晰度越来越高,显示驱动芯片需要传输和处理的数据也随之加大。而作为现代先进封装核心技术之一的凸块制造技术,可在晶圆表面制作数百万个极其微小的凸块以代替传统打线封装的引脚,满足了显示驱动芯片高 I/O 数量的需求。由于金具有良好的导电性、可加工性以及抗腐蚀性,因而金凸块制造技术被广泛应用于显示驱动芯片的封装,同时针对近年来消费电子市场的需求,公司布局了铜镍金(CuNiAu)凸块技术,为显示驱动芯片提供了更具性价比的封装解决方案。完成凸块制造的晶圆经过晶圆测试(CP)后,根据后续封装方式不同又可分为玻璃覆晶封装(COG)、柔性屏幕覆晶封装(COP)、薄膜覆晶封装(COF)等主要制程环节,具体情况如下:

工艺制程名称	流程制程具体描述	下游应用	公司实力	产品图示
Gold Bumping	通过真空溅镀、黄光(光刻)、电镀以及蚀刻等制程在晶圆焊盘表面制作的微型金凸块,是向上游晶圆制造领域的技术延伸,可极大提高芯片电性能,同时增加电流传输效率、减少电阻及热阻	由于显示驱动芯片对细间距、高脚数、导电性能等指标要求较高,金凸块制造技术可以满足上述需要,因而大量在显示驱动芯片封装领域使用	公司金凸块制造工艺可实现最细间距 6μm,在 12 吋晶圆上可实现上百万个凸块;同时凸块硬度可超过 105HV(维氏硬度),可用于 COP 封装形式下的 AMOLED 显示驱动芯片	
CuNiAu Bumping	通过真空溅镀、黄光(光刻)、电镀(三层金属材料电镀)以及蚀刻等制程在晶圆焊盘表面制作的微型铜镍金凸块,相较于金凸块,有较大的成本优势。	由于显示驱动芯片对细间距、高脚数、导电性能等指标要求较高,铜镍金凸块制造技术可以满足上述需要,且具备成本优势因而越来越多在显示驱动芯片封装领域使用	公司铜镍金凸块制造工艺可实现最细间距 8μm,在 12 吋晶圆上可实现上百万个凸块	
CP	用专业测试机台对经过凸块制造后的晶圆上每个芯片的功能参数进行测试,保障芯片符合设计的各项参数指标,该工序可在晶圆切割前筛选出不良品,避免在不合格品芯片上进行后续加工。显示驱动芯片测试所涉及的参数指标较多,需要配备专用机台系统,对机台的要求较高	芯片测试在集成电路产业链中起着必不可少的作用,每颗芯片都需经过 100%测试才能保证其正常使用	公司测试环节拥有高效的自动化管理体系及工程能力,可提供 -55℃低温至 150℃高温区间内的测试环境以及高达 6.5Gbps 的测试频率,可满足高性能芯片的测试要求	
COG/COP	将完成测试后的晶圆进行研磨切割,并将研磨切割后的单颗芯片放置在特制的 Tray 盘中,以供面板厂将芯片覆晶封装在玻璃基板(COG)或柔性屏幕(COP)上。对公司而言,COG、COP 封装环节的工艺流程及出货形态基本相似	COG 适用于中小尺寸的面板,如手机、平板电脑等,工艺成熟且具有较大的成本优势;COP 主要适用于曲面或可折叠的 AMOLED 屏幕,是目前较为先进的面板封装工艺,也是未来显示面板发展的主流技术,但成本相对较高	公司的 COG/COP 工艺,可研磨 50μm 超薄芯片,有效减小封装体积并提升芯片性能。同时,公司可搭配晶圆厂的先进制程,提供激光开槽与硬刀切割的切割工艺	
COF	将完成测试后的晶圆进行研磨切割,并将研磨切割后的单颗芯片倒装至卷带式薄膜上,利用热压合使金凸块与卷带式薄膜上的引脚一次性结合,将完成封装后的芯片进行最终测试(FT)后,提供给面板厂商用于后续工序,经该工艺封装后的芯片具有低阻抗、高密度、散热性能高、体积小、易弯折等特点	主要应用于电视、显示器等中大尺寸面板,少部分用于小尺寸面板,如智能手机全面屏的封装;COF 封装成本相对较高,可实现较高的屏占比,同时适用于 LCD 和 AMOLED 硬屏封装	公司 COF 工艺可实现最小 12μm 的超细间距引脚结合,可为客户提供不同的散热解决方案,同时首创了 125mm 大版面覆晶封装技术,并具有双面铜结构、多芯片封装等先进能力,满足了未来更高阶显示技术的需求	

依托在显示驱动芯片封测领域多年来的积累以及对金凸块制造技术深刻的理解,公司于 2015 年将业务拓展至多元化芯片封测领域,目前该领域已成为公司业务的重点组成部分以及未来发展的重点板块。公司现可为客户提供包括铜柱凸块(Cu Pillar)、铜镍金凸块(CuNiAu Bumping)、锡凸块(Sn Bumping)在内的多种凸块制造和晶圆测试服务,并可提供后段 DPS 和载板覆晶封装服务助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试的解决方案,有助于进一步增强公司的技术领先优势,并拓宽服务领域至如高性能计算、数据中心、自动驾驶等头端市场,争取在国际竞争中占据有利地位。同时,为适应近年来新能源等大功率领域对功率芯片需求的急速增长,公司正积极建制功率器件相关的晶圆正面金属化(FSM)、背面减薄及金属化(BGBM)和后段铜片夹扣键合(Cu Clip)封装工艺。

工艺制程名称		具体说明及特点	产品图示
凸块制造	铜柱凸块(Cu Pillar)	凸块结构主要由铜柱和锡帽构成,需经过溅镀、黄光、电镀、蚀刻、回流焊等主要工艺环节,同时可增加钝化层(Re-passivation),使芯片表面的抗腐蚀、抗击穿以及缓冲能力大幅提升,也可通过增加重布线制程对芯片表面线路进行重新布局。公司可提供基于铜柱凸块的 Fan-in WLCSP 解决方案。	
	铜镍金凸块(CuNiAu)	采用晶圆凸块的基本制造流程,电镀厚度超过 10μm 以上的铜镍金凸块。新凸块替代了芯片的部分线路结构,优化了 I/O 设计,大幅降低了导通电阻。目前公司可提供主流尺寸晶圆的铜镍金凸块及重布层、再钝化服务,满足了大电流下电源类芯片降低导通电阻的需求。公司是中国境内首家实现铜镍金凸块大规模量产的企业。	
	锡凸块(Sn Bumping)	与铜柱凸块流程相似,凸块结构主要由铜焊盘和锡帽构成(一般配合再钝化和 RDL 层),差别主要在于焊盘的高度较低,同时锡帽含金是成品锡球通过钢板印刷,在助焊剂以及氮气环境下高温熔融回流与铜焊盘形成的整体产物。锡凸块一般是铜柱凸块尺寸的 3-5 倍,球体较大,可焊性更强(也可以通过电镀形成锡球)。公司可提供基于锡凸块的 Fan-in WLCSP 解决方案。	
CP		与显示驱动芯片封测业务中的 CP 环节类似,但针对不同类型的芯片,需要拥有专门的机台和测试系统以满足测试需要。	
DPS		DPS作为 Fan-in WLCSP 中的重要环节,指将经测试后的晶圆研磨切割成单个芯片,并准确放置在特制编带中。公司具备钻石硬刀切割、激光开槽、激光切割等制程能力,切割后的芯片封装尺寸可从最小 0.2mm 到最大 6mm,同时可对芯片进行 6 个面的红外光透视检查。此外,公司拥有砷化镓、氮化镓、钽酸锂等新一代半导体材料的 DPS 能力。配合铜柱凸块、锡凸块,可用于电源管理芯片、射频前端芯片等芯片的 Fan-in WLCSP 制程。	
载板覆晶封装		覆晶封装是一种先进的芯片封装技术,它将芯片的有源面(即带有焊盘的一面)直接朝向载板(如框架 Leadframe 或基板 Substrate),并通过焊点(如锡球、铜柱等)实现电气连接。载板覆晶封装技术因其高密度、高性能和高可靠性,广泛应用于高性能计算、通信、消费电子等领域。	
正面金属化 FSM&背面减薄及金属化 BGBM		FSM 工艺指在功率芯片正面导通铝垫上形成金属层,典型组合如 Ti/NiV/Ag;BGBM 工艺指将功率芯片减薄至指定厚度,并在晶背上覆盖金属层,典型组合如 Ti/NiV/Ag;此工艺可使得功率芯片获得超低的导通电阻值、更高的电流承载量、更快的开关速度以及更好的导热性能。	
铜片夹扣键合 Cu Clip		通过回流焊接的方式,将有特殊形状的铜片焊接于芯片上,实现芯片正面源极与外引脚的互联,铜片夹扣键合产品的原材料是通过腐蚀或冲压工艺制造而成的铜片,可以有效降低导通阻抗。	

2.2 主要经营模式

就集成电路封装测试行业而言,目前行业内主要存在 IDM 公司以及专业封装测试公司(OSAT)两类。基于技术优势、下游产品、客户群体、产业链配置等因素,相较于集芯片设计、制造、封测等多个产业链环节于一身的 IDM 模式,公司专注于集成电路产业链中的先进封装测试服务。报告期内,公司主要经营模式保持稳定,未发生重大变化。影响公司经营模式的关键因素主要在于产业政策的变化或推进、市场竞争情况变化、行业发展趋势、前沿产品技术的发展与应用等。未来,公司将积极巩固现有业务优势,把握市场、技术等方面的发展前瞻,实现市场竞争力的稳固与加强。

(1)盈利模式

公司主要从事集成电路的先进封装测试,可为客户提供定制化的整体封测技术解决方案,处于半导体产业链的中下游。作为专业的封装测试企业(OSAT),公司采用集成电路封装测试行业通用的经营方式,即由 IC 设计公司(Fabless)委托晶圆代工企业(Foundry)将制作完成的晶圆运送至公司,公司按照与 IC 设计公司约定的技术标准设计封测方案,并对晶圆进行凸块制造、测试和后段封装等工序,再交由客户指定的下游厂商以完成终端产品的后续加工制造。公司主要通过提供封装与测试服务获取收入和利润。

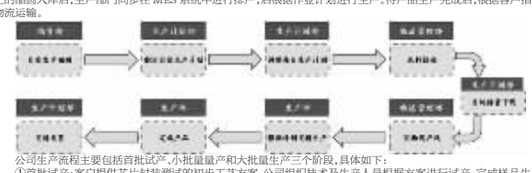
(2)采购模式

公司设置采购部,统筹负责公司的采购事宜。根据实际生产需要,采购部按生产计划采购金盐、靶材、光阻液等原材料以及其他各类辅料,并负责对生产设备及配套零部件进行采购。针对部分价格波动较大且采购量较大的原材料(如金盐等),在实际需求的基础之上,公司会根据大宗商品价格走势择机采购以控制采购成本。由需求部门提出采购需求,经审核后产生请购单,采购部随后进行询价、比价和议价流程,通过综合选比后确定供应商并生成采购订单。供应商根据采购订单进行供货,采购部进行交期追踪及请款作业。公司建立了《供应商管理办法》等供应商管理体系,每个季度定期对供应商进行考核,并对品质、交期和配合度三大指标进行考核并量化评分。

(3)生产模式

公司建立了一套完整的生产管理体系,由于封测企业需针对客户的不同产品安排定制化生产,因此公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司下设凸块中心、显示封装中心、测试暨客户工程中心与品保本部负责生产与产品质量管控。

生产流程方面,根据客户订单及销售预测,公司生产部门制定每月生产计划,并根据实际生产情况进行动态调整。待加工的晶圆入库后,生产部门同步在 MES 系统中进行排产,后根据作业计划进行生产。待产品生产完成后,根据客户指示安排物流运输。



公司生产流程主要包括首批试产、小批量量产和大批量生产三个阶段,具体如下:

①首批试产:客户提供芯片封装测试的初步工艺方案,公司组织技术及生产人员根据方案进行试产,完成样品生产后交由客户验收。

②小批量量产:首批试产后的样品经客户验证,如满足相关技术指标的要求且封装的产品符合市场需求,则进入小批量量产阶段。此阶段,公司着重进行生产工艺、产品良率的提升。

③大批量生产:在大批量生产阶段,生产计划部门根据客户订单需求安排生产、跟踪生产进度并向客户提供生产进度报告。此阶段,公司需保障产品具有较高的可靠性和良率水平,并具备较强的交付能力。

(4)销售模式

公司下设行销中心,包括显示行销本部、非显示行销本部与客户服务部三大部门,并在中国台湾设立办事处负责当地客户的开发和维护。公司销售环节均采用直销的模式。公司主要通过主动开发、客户引荐等方式获取新的客户资源。

(5)研发模式

公司主要采用自主研发模式,公司以市场和客户为导向,坚持突破创新,不断发展先进产品封测技术,并设立专业的研发组织及完善的研发管理制度。公司研发流程主要包括立项、设计、工程试作、项目验收、成果转化 5 个阶段。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司的主营业务为集成电路的封装测试,根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”;根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”下的“集成电路制造业(C3973)”。

公司是集成电路高端先进封装测试服务商,可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务,覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。公司在以凸块制造(Bumping)和晶圆封装(FC)为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位,是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商,也是境内最早专业从事 8 吋及 12 吋显示驱动芯片全制程(Turn-key)封测服务的企业之一。

(2)行业发展阶段及基本特点

集成电路封测是集成电路产品制造的后道工序,指将通过测试的晶圆按产品型号及功能需求加工得到独立集成电路的过程,具体包含封装与测试两个主要环节。

集成电路封装是指将集成电路与引脚相连接以达到在接电信号的目的,并使用塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料制作外壳保护集成电路免受外部环境的损伤。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用,也为集成电路提供了一个稳定可靠的工作环境,使集成电路能够发挥正常的功能,并保证其具有高稳定性和可靠性。

集成电路测试包括进入封装前的晶圆测试(CP)以及封装完成后的成品测试(FT),晶圆测试主要是在晶圆层面上检验每个晶粒的电性,成品测试主要检验切割后产品的电性和功能,目的是在于将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的芯片筛选出来。

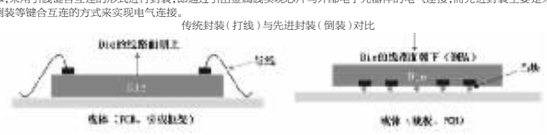
由于不同集成电路产品电性能、尺寸、应用场景等因素各不相同,因此造成封装形式多样复杂。根据是否具有封装基板以及封装基板的材质,集成电路封装产品可以分为四大类,即陶瓷基板产品、引线框架基板产品、有机基板产品和无基板产品。其中陶瓷基板产品、引线框架基板产品和有机基板产品都可以分为倒装封装和引线键合封装两种方式,而无基板产品又可具体分为扇出型封装(Fan-out)和扇入型晶圆级芯片尺寸封装(Fan-in WLCSP)两类。

集成电路封装形式的分类

数据来源:YoleD é veloppement

在业内,先进封装技术与传统封装技术主要以是否采用焊线(即引线焊接)来区分,传统封装一般利用引线框架作为载体,采用引线键合互连的形式进行封装,即通过引出金属线实现芯片与外部电子元器件的电气连接;而先进封装主要是采用倒装等键合互连的方式来实现电气连接。

传统封装(打线)与先进封装(倒装)对比



(3)主要技术门槛

公司所处的先进封测行业,具有较高的技术门槛和难点,需要企业在技术创新、设备投入、人才培养和产业链合作等方面进行持续的努力。①如金凸块制造环节具有溅镀、黄光(光刻)、蚀刻、电镀等多道环节,需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚,并且对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均有较高的要求;②铜柱凸块、铜镍金凸块、锡凸块制造环节都具有再钝化层制作、溅镀、黄光(光刻)、多次电镀、蚀刻等多道环节,需要在单片晶圆表面数万颗芯片内实现多次电镀、微间距线圈环绕、高介电层隔离、多层堆叠等技术。以铜镍金凸块为例,芯片覆铜比例大,大面积的覆铜通常会产生较高的应力,对芯片产生破坏,而应力释放就需要从种子层的材料、厚度、工艺控制,以及钝化层的材料、厚度、设计等各方面进行控制,另外对于多次电镀层高度的均匀性要求、微间距线圈宽度和间距的精准控制、多层结构各层间高度控制和层与层间的结合力都有着很高的要求;③显示驱动芯片对性能要求高,主要使用金凸块,但是金材料带来了高成本,铜镍金凸块制造技术不断突破创新,扩展了铜镍金凸块在显示驱动芯片的应用,实现了高精度、高可靠性、微细间距的技术水平,同时大幅降低了材料成本;④先进封装芯片的测试环节,需要具备全面的测试和验证流程,以确保芯片在各种工作条件下的性能和可靠性,这包括电气性能测试、信号完整性测试、不同温度环境下的性能测试等,测试技术需要不断更新以适应新的应用领域及环境,随着 5G、物联网、人工智能等新兴技术的发展,先进封装测试技术的重要性将进一步凸显,成为推动半导体产业发展的关键因素;⑤在 COF 封装环节,由于显示驱动芯片 I/O 接点间距最小仅数微米,需要在几十毫秒内同时将数千颗 I/O 接点一次性精准、稳定、高效地进行结合,难度较大,需要配备专门的技术团队进行持续研发。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自设立以来固定位于集成电路的先进封装业务,子公司苏州颀中成立于 2004 年,是境内最早实现显示驱动芯片全制程封测能力的企业之一。通过二十多年的辛勤耕耘,公司历经数个半导体行业周期,业务规模和技术水平不断壮大,在境内显示驱动芯片封测领域常年保持领先地位,同时在整个封测行业的知名度和影响力不断提升。2025 年,公司显示驱动芯片封测业务销售量 20.8 亿颗,营业收入 200,768.29 万元,是境内收入规模最高的显示驱动芯片封测企业,在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名。

在不断巩固显示驱动芯片封测领域优势地位的同时,公司逐渐将业务扩展至以电源管理芯片、射频前端芯片为主的多元化芯片封测领域,持续延伸技术产品线,在新制程、新产品等领域不断发力,积极扩充公司业务版图,向综合类集成电路先进封测厂商迈进。2025 年,公司多元化芯片封测营业收入 15,162.88 万元。

多年来公司在产品质量、可靠性、专业服务等方面赢得了客户的高度认可,积累了联咏科技、敦泰电子、奇景光电、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、奕斯伟计算、矽力杰、杰华特、南芯半导体等境内外优质客户资源。

2025 年公司持续深化研发创新,巩固细分领域市场优势,稳步推进产能提升,子公司苏州颀中荣获“江苏省省级企业技术中心”等荣誉称号。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在摩尔定律放缓背景下,为寻求提升集成电路产品系统集成、高速、高频、三维、超细节距互连等特征,提升芯片集成密度和芯片内连接性能已成为当今集成电路产业的新趋势。先进封装技术能够在再布线层间距、封装垂直高度、I/O 密度、芯片内电流通过距离等方面提供更多解决方案。封装环节对于提升芯片整体性能愈发重要,行业内先后出现了 Bumping、FC、WLCSP、2.5D、3D 等先进封装技术,先进封装已经成为后摩尔时代的重要途径。

随着 5G 通信技术、物联网、大数据、人工智能、视觉识别、新能源汽车、自动驾驶等新兴应用场景的快速发展,为集成电路产业发展带来巨大的机会,同时新兴应用市场对集成电路多样化和复杂程度的要求越来越高,并且原有终端设备的结构调整为集成电路产业带来新的增长动力。如 4k 及 8k 高清电视占比的提升促进了显示驱动芯片需求数量的增加,又如 5G 时代的到来推动了射频前端芯片需求量不断提升,技术变革和新兴下游市场的需求变革为集成电路产业提供了巨大增长动力。同时得益于各大面板厂如京东方、维信诺、天马等对 AMOLED 的持续布局,AMOLED 渗透率不断增长。根据 CINNO Research 数据显示,2025 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 9.2 亿片,同比增长 4.7%。另根据 Omdia 预估,AMOLED 智能手机的需求将持续增长。随着其他应用的提升,AMOLED 显示驱动芯片市场在 2028 年前将保持双位数的增长。同时国内 AMOLED 产能的持续释放及其向低价产品市场的不断渗透,也成为了推动市场发展的关键因素。

近年来,随着中国大陆电子制造业快速发展,国家对集成电路产业重视程度不断提升,推出了一系列法规和产业政策推动行业的发展,同时在税务、技术、人才等多方面提供了有利支持。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,001,256,841.71	6,991,013,658.68	14.45	7,153,333,609.63
归属于上市公司股东的净资产	6,115,968,766.39	6,003,292,022.20	1.88	5,830,126,768.94
营业收入	2,190,261,246.45	1,959,375,628.33	11.78	1,629,340,035.50
利润总额	300,349,680.80	369,022,049.26	-18.61	418,668,844.32
归属于上市公司股东的净利润	265,790,812.36	313,276,970.57	-15.16	371,662,508.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,793,438.00	276,676,779.67	-10.44	339,685,424.03
经营活动产生的现金流量净额	611,000,524.92	690,346,690.70	-11.49	541,275,168.61
加权平均净资产收益率(%)	4.38	5.29	减少 0.91 个百分点	7.59
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38	0.33
研发投入占营业收入的比例(%)	8.94	7.89	增加 1.05 个百分点	6.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	474,310,296.66	521,450,624.57	608,843,952.69	585,656,372.53
归属于上市公司股东的净利润	29,448,437.25	69,742,965.15	85,348,767.25	81,250,642.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,982,665.90	67,541,864.13	80,954,805.57	70,314,102.40
经营活动产生的现金流量净额	74,234,875.87	159,956,117.76	146,191,401.46	230,618,129.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,573
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,886
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合肥颀中科技控股有限公司	0	397,127,159	33.40	397,127,159	无	0	国有法人
Chipmore Holding Company Limited	0	302,389,708	25.43	302,389,708	无	0	境外法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	0	123,639,298	10.40	123,639,298	无	0	其他
CTC Investment Company Limited	-11,699,800	22,698,078	1.91	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	8,973,004	12,832,259	1.08	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	538,342	10,782,312	0.91	0	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司-自有四号	-1,250,882	7,013,580	0.59	0	无	0	其他
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙)	0	5,030,411	0.42	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	481,844	4,374,581	0.37	0	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司-兴益传统 14 号	0	4,207,416	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			合肥颀中科技控股有限公司和合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)是一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

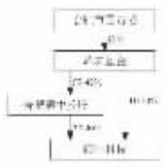
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

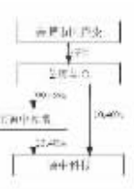
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 219,026.12 万元,较上年同期增长 11.78%;实现归属于上市公司股东的净利润 26,579.08 万元,较上年同期减少 15.16%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 24,779.34 万元,较上年同期减少 10.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688352　证券简称:颀中科技　公告编号:2026-021
转债代码:118059　转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前合肥颀中科技股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股派发现金红利金额不变,相应调整分配的总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本事项已经第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为人民币 1,357,358,875.72 元,母公司报表未分配利润为人民币 314,447,013.59 元。经公司第二届董事会第十次会议决议,同意公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 1,189,037,288 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 8,714,483 股后的股本 1,180,322,805 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 59,016,140.25 元(含税),2025 年度公司现金分红(含 2025 年半年度已派发现金红利 59,016,140.25 元)占 2025 年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 44.41%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额 118,032,280.50 元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 100,398,688.97 元,现金分红和回购金额合计 218,430,969.47 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 82.18%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额 0 元,现金分红和回购并注销金额合计 118,032,280.50 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 44.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派发现金红利金额不变,相应调整分配的总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红总额(元)

项目	2025年度	2024年度
现金分红总额(元)	118,032,280.50	118,903,728.80
回购注销总额(元)	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	265,790,812.36	313,276,970.57
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	314,447,013.59	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	236,936,009.30	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-	
最近三个会计年度平均净利润(元)	289,533,891.47	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	236,936,009.30	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 3000 万元	否	
现金分红比例(%)	81.83	
现金分红比例(E)是否低于 30%	否	
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	350,474,319.08	
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是	
最近三个会计年度累计营业收入(元)	4,149,636,874.78	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	8.45%	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在 15%以上	否	
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

注:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第二款规定,公司上市不满三个完整会计年度的,最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度,公司于 2023 年 4 月 20 日上市,因此上表数据仅填列公司 2024 年和 2025 年度数据。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,本预案符合《合肥颀中科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展;

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 20 日

证券代码:688352　证券简称:颀中科技　公告编号:2026-022
转债代码:118059　转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法